# Наномеханика Nanomechanics of materials and systems

# Lecture 3

# Механические напряжения и деформации в тонких пленках.

Mechanical stresses and strains in thin films.

### Деформация сплошной среды Deformation of continuum

Transformation of an object  $d\underline{\mathbf{R}} = \underline{\mathbf{F}} \cdot d\underline{\mathbf{r}} = (\underline{\mathbf{R}}\nabla) \cdot d\underline{\mathbf{r}} = d\underline{\mathbf{r}} \cdot (\nabla\underline{\mathbf{R}})$  $d\underline{\mathbf{r}} = \underline{\mathbf{F}}^{-1} \cdot d\underline{\mathbf{R}} = (\underline{\mathbf{r}}\nabla) \cdot d\underline{\mathbf{R}} = d\underline{\mathbf{R}} \cdot (\nabla\underline{\mathbf{r}})$  $\underline{\mathbf{R}} = \underline{\mathbf{R}}(\underline{\mathbf{r}})$  $\mathbf{F}^{\mathbf{T}} = (\nabla \mathbf{R}) = \mathbf{\underline{e}}_{i} \partial \partial r_{i} R_{j} \mathbf{\underline{E}}_{j} = \partial R_{j} (\mathbf{\underline{r}}) / \partial r_{i} \mathbf{\underline{e}}_{i}$  $\mathbf{\underline{E}}_{j}$  $\mathbf{\overline{F}}^{j} = (\mathbf{R} \nabla) = \partial R_{j} (\mathbf{\underline{r}}) / \partial r_{i} \mathbf{\underline{E}}_{j} \mathbf{\underline{e}}_{i} = \partial \mathbf{\underline{R}} / \partial \mathbf{\underline{r}}$ 

Displacement field  $\underline{u}$  $\underline{R} = \underline{r} + \underline{u}$ 

> Конечное или деформированное состояние



Все функции однозначны, непрерывны и дифференцируемы нужное число раз

# Тензор малой деформации Infinitesimal strain tensor

$$\begin{vmatrix} \frac{\partial u_1}{\partial x_1} & \frac{1}{2} \left( \frac{\partial u_2}{\partial x_1} + \frac{\partial u_1}{\partial x_2} \right) & \frac{1}{2} \left( \frac{\partial u_3}{\partial x_1} + \frac{\partial u_1}{\partial x_3} \right) \\ \frac{1}{2} \left( \frac{\partial u_1}{\partial x_2} + \frac{\partial u_2}{\partial x_1} \right) & \frac{\partial u_2}{\partial x_2} & \frac{1}{2} \left( \frac{\partial u_2}{\partial x_3} + \frac{\partial u_3}{\partial x_2} \right) \\ \frac{1}{2} \left( \frac{\partial u_1}{\partial x_3} + \frac{\partial u_3}{\partial x_1} \right) & \frac{1}{2} \left( \frac{\partial u_3}{\partial x_2} + \frac{\partial u_2}{\partial x_3} \right) & \frac{\partial u_3}{\partial x_3} \end{vmatrix}$$

$$\underline{\underline{\varepsilon}} = \frac{1}{2} (\nabla \underline{u} + \underline{u} \nabla) = (\nabla \underline{u})^s$$
 тензор деформации - strain tensor  
 $\varepsilon_{kl} = \frac{1}{2} (\frac{\partial u_l}{\partial x_k} + \frac{\partial u_k}{\partial x_l})$   
 $\underline{\underline{\beta}} = \nabla \underline{u}$  тензор дисторсии - deformation gradient

Физический смысл  $\varepsilon_{ii}$  – удлинение/укорочение вдоль оси оси i Физический смысл  $\varepsilon_{ii}$  – изменение углов между осями  $\theta/2$ 

## Тензор вращений Rotation tensor

$$\begin{aligned} & \left\| \begin{array}{ccc} 0 & \frac{1}{2} \left( \frac{\partial u_2}{\partial x_1} - \frac{\partial u_1}{\partial x_2} \right) & \frac{1}{2} \left( \frac{\partial u_3}{\partial x_1} - \frac{\partial u_1}{\partial x_3} \right) \\ & \frac{1}{2} \left( \frac{\partial u_1}{\partial x_2} - \frac{\partial u_2}{\partial x_1} \right) & 0 & \frac{1}{2} \left( \frac{\partial u_2}{\partial x_3} - \frac{\partial u_3}{\partial x_2} \right) \\ & \frac{1}{2} \left( \frac{\partial u_1}{\partial x_3} - \frac{\partial u_3}{\partial x_1} \right) & \frac{1}{2} \left( \frac{\partial u_3}{\partial x_2} - \frac{\partial u_2}{\partial x_3} \right) & 0 \end{aligned} \right\| \\ \\ & \underline{\Omega} = \frac{1}{2} \left( \nabla \underline{u} - \underline{u} \nabla \right) = \nabla \underline{u}^A \\ & \Omega_{kl} = \frac{1}{2} \left( \frac{\partial u_l}{\partial x_k} - \frac{\partial u_k}{\partial x_l} \right) \end{aligned}$$

Физический смысл – вращение вокруг мгновенной оси  $\nabla \times \underline{u}$ 

### Тензор напряжений Коши Cauchy stress tensor



 $\underline{t}_n = \underline{n} \cdot \underline{\underline{\sigma}};$ 

нормальные напряжения  $\sigma_{nn} = \underline{n} \cdot \underline{\sigma} \cdot \underline{n}$ ; normal stress касательные напряжения  $\sigma_{ns} = \underline{n} \cdot \underline{\sigma} \cdot \underline{s}$ ; shear stress

$$\underline{\underline{\sigma}} = \sigma_{ij} \underline{\underline{e}}_i \underline{\underline{e}}_j = \sum_{i,j} \underline{\underline{t}}_i \underline{\underline{e}}_j$$

# Закон Гука (Hooke's law)

$$\underline{\underline{\sigma}} = \overset{(4)}{\underline{\underline{C}}} \cdot \underline{\underline{\varepsilon}}; \qquad \sigma_{ij} = C_{ijkl} \varepsilon_{kl} \qquad \sigma_{ij} = C_{ijkl} \frac{\partial u_k}{\partial x_l}$$

тензор упругих констант (stiffness tensor)

$$C_{ijkl} = C_{jikl} = C_{ijlk} = C_{jilk}$$

- кубическая симметрия 3 независимых константы: с<sub>44</sub>≠(с<sub>11</sub>-с<sub>12</sub>)/2
- гексагональная симметрия 5 независимых констант:  $c_{11}$ ,  $c_{12}$ ,  $c_{13}$ ,  $c_{33}$ ,  $c_{44}$ ;  $c_{66} = (c_{11} c_{12})/2$
- тетрагональная и тригональная симметрии 9 независимых констант
- ромбическая симметрия 9 независимых констант
- моноклинная симметрия 13 независимых констант
- триклинная симметрия 21 независимая константа

### Тензор упругих констант изотропного материала (stiffness tensor for isotropic material)

$$\mathbf{c} = \begin{bmatrix} c_{11} & c_{12} & c_{12} & 0 & 0 & 0\\ c_{12} & c_{11} & c_{12} & 0 & 0 & 0\\ c_{12} & c_{12} & c_{11} & 0 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 0 & c_{44} & 0 & 0\\ 0 & 0 & 0 & 0 & c_{44} & 0\\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & c_{44} \end{bmatrix}$$
$$c_{44} = (c_{11} - c_{12})/2$$

$$\mathbf{c} = \begin{bmatrix} 2\mu + \lambda & \lambda & \lambda & 0 & 0 & 0 \\ \lambda & 2\mu + \lambda & \lambda & 0 & 0 & 0 \\ \lambda & \lambda & 2\mu + \lambda & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \mu & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \mu & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \mu \end{bmatrix}$$
$$\lambda = c_{12},$$
$$\mu = c_{44} = (c_{11} - c_{12})/2$$

$$E = \frac{\mu(3\lambda + 2\mu)}{\lambda + \mu}$$

Коэффициент Пуассона (Poisson ratio)

$$\nu = \frac{\lambda}{2\lambda + 2\mu)}$$

Модуль сдвига (shear modulus) G =  $\mu$ 

$$\epsilon_{11} = \frac{1}{E} \left[ \sigma_{11} - \nu (\sigma_{22} + \sigma_{33}) \right] \qquad \epsilon_{23} = \frac{1}{2\mu} \sigma_{23}$$

$$\epsilon_{22} = \frac{1}{E} \left[ \sigma_{22} - \nu (\sigma_{11} + \sigma_{33}) \right] \qquad \epsilon_{31} = \frac{1}{2\mu} \sigma_{31}$$

$$\epsilon_{33} = \frac{1}{E} \left[ \sigma_{33} - \nu (\sigma_{11} + \sigma_{22}) \right] \qquad \epsilon_{12} = \frac{1}{2\mu} \sigma_{12}$$

Полная система уравнений статической теории упругости Full system of equations in static elasticity

- (3) $\nabla \cdot \underline{\sigma} + \underline{b} = 0$  $\underline{\varepsilon} = (\nabla \underline{u})^S$ (6)  $\underline{\sigma} = \underline{{}^{(4)}C} \cdot \underline{\varepsilon}$ (6) Unknown  $\underline{\sigma}(6), \underline{\varepsilon}(6), \underline{u}(3)$ Boundary conditions  $\underline{u}|_{S} = \underline{u}_{0}$  or  $\underline{n} \cdot \underline{\sigma} = \underline{t}_{n}$

# Эпитаксия (Epitaxy)

#### Гетероэпитаксия



# Запрещенная зона и параметры решетки полупроводников



Adapted from V. Keramidas and R. Nahory. Lucent Technologies, Murray Hill, New Jersey, 2001

# Правило Вегарда (Vegard's rule)

Параметр решетки бинарного твердого раствора (сплава) двух материалов с одинаковой стуктурой решетки может быть найден путем линейной интерполяции между параметрами решетки исходных соединений, например для твердого раствора Si<sub>1-x</sub>Ge<sub>x</sub>:

$$a_{\mathrm{SiGe}} = (1-x) a_{\mathrm{Si}} + x a_{\mathrm{Ge}}.$$

### Примеры полупроводниковых гетероструктур

Cube-on-Cube (001) CdZnTe/ZnTe/GaAs/Si (001) Hex-on-Hex (0001) GaN/Sapphire (0001)

CdZnTe a = 0.646 nm		GaN a = 0.318 nm c = 0.5166 nm	
ZnTe a = 0.610 nm	$\varepsilon_m = 5.6\%$		ε <sub>m</sub> = 14.5%
GaAs a = 0.565 nm	$\varepsilon_m = 7.4\%$	Sapphire $(Al_20_3)$ a = 0.4759 nm a/ $\sqrt{3}$ = 0.2748 nm	
Si a = 0.543 nm	€ <sub>m</sub> = 3.9%	c = 1.299  nm	

# Причины рассогласование параметров решетки пленки и подложки





A HRTEM [110] cross-sectional view of a coherent interface that develops with no interface defects during the epitaxial growth of an Al film on a  $MgAl_2O_4(001)$  substrate. (After Ruhle, Max-Planck Institut fur Metallforschung, Germany.)

# Собственные и упругие деформации Eigenstrain and elastic strain

 $\underline{u} = \underline{u} + \underline{u}^*$ , где  $\underline{u}^*$  - неупругое (пластическое) смещение Тензор дисторсии <u>β</u> (distortion tensor)

$$\underline{\beta}^{t} = \nabla(\underline{u} + \underline{u}^{*})$$

$$\underline{\varepsilon}^{t} = \underline{\varepsilon} + \underline{\varepsilon}^{*} = (\nabla \underline{u} + \nabla \underline{u}^{*})^{S}$$

$$\underline{\sigma} = \underline{(^{4})}\underline{C} \cdot \cdot \underline{\varepsilon}$$

$$\nabla \cdot \underline{\sigma} + \underline{b} = 0$$

Граничные условия  $\underline{u}(\underline{R})|_{S} = \underline{u}_{o}(\underline{R})$ Boundary conditions  $\underline{n} \cdot \underline{\sigma} = \underline{F}$ 

### Собственные напряжения Eigenstrain



Film and substrate separated, but with distributed force f acting on the film edge so that its strain is exactly the mismatch strain. This loading gives rise to an equi-biaxial state of stress at each material point in the film; such a state of stress with magnitude  $\sigma$  is illustrated on the right side.

### Пленка на недеформируемой подложке Film on a rigid substrate



Материалы с кубической решеткой и ориентацией (001)  $\sigma_{\rm m} = M_{\rm f} \varepsilon_{\rm m};$   $M_{\rm f} = c_{11} + c_{12} - 2c_{12}^{-2}/c_{11};$   $\varepsilon_{33} = -2\varepsilon_{\rm m} c_{12}/c_{11}$ 

### Изотропный материал Isotropic material

$$\sigma_{zz} = 0; \sigma_{rr} = \sigma_{\theta\theta}; \varepsilon_{rr} = \frac{\sigma_{rr}}{E} - v \frac{\sigma_{\theta\theta}}{E} = \frac{\sigma_{rr}(1-v)}{E}$$
$$M_f = E_f / (1-v)$$



# Критерий недеформируемости подложки Criterion for the rigid substrate assumption

Compatibility of deformation requires

$$\epsilon_{\rm f} - \epsilon_{\rm s} = \epsilon_{\rm m}$$

Equilibrium requires

$$M_{\rm f}\epsilon_{\rm f}h_{\rm f} + M_{\rm s}\epsilon_{\rm s}h_{\rm s} = 0$$

$$\epsilon_{\rm f} = \epsilon_{\rm m} \frac{h_{\rm s} M_{\rm s}}{h_{\rm f} M_{\rm f} + h_{\rm s} M_{\rm s}}, \quad \epsilon_{\rm s} = -\epsilon_{\rm m} \frac{h_{\rm f} M_{\rm f}}{h_{\rm f} M_{\rm f} + h_{\rm s} M_{\rm s}}$$

### Рентгеновская дифракция на упруго-напряженных пленках X-ray diffraction in strained films



Материалы с кубической решеткой и ориентацией (001)  $\sigma_{\rm m} = M_{\rm f} \varepsilon_{\rm m};$   $M_{\rm f} = c_{11} + c_{12} - 2c_{12}^{-2}/c_{11};$   $\varepsilon_{33} = -2\varepsilon_{\rm m} c_{12}/c_{11}$ 

# Пленка и подложка с кубической симметрией с ориентацией {001}

$$M(001) = c_{11} + c_{12} - 2c_{12}^2 / c_{11} = \frac{E}{1 - v}$$
$$E(100) = \frac{(c_{11} - c_{12})(c_{11} + 2c_{12})}{(c_{11} + c_{12})}$$

$$v(100) = \frac{c_{12}}{(c_{11} + c_{12})}; 1 - v = \frac{c_{11}}{(c_{11} + c_{12})}$$

### Наряженная пленка на деформируемой подложке Stressed film on a deformable substrate



In the upper diagram, the elastic mismatch is maintained by externally applied traction of magnitude  $\sigma_m$ ; there is no interaction between the film and substrate in this condition and the substrate is unrestrained. If the externally applied traction is relaxed, the mismatch strain in the film induces a curvature in the substrate as shown in the lower diagram.

### Деформации в пленке и подложке Strain in a film/substrate sandwich

Если деформации зависят только от z:  $\varepsilon = \varepsilon(z)$ 

$$abla imes \underline{\varepsilon}^{t} \times \nabla = 0$$
  
 $\frac{\partial^{2}}{\partial z^{2}} (\varepsilon_{ij} + \varepsilon *_{ij}) = 0; \quad i, j = x, y$ 
then  $\varepsilon_{ij} = -\varepsilon *_{ij} + a_{ij} + zb_{ij}$ 
Для подложки  $\varepsilon *_{ij} = 0$  (substrate
Для пленки  $\varepsilon *_{ij} \neq 0$  (film)

$$\epsilon_{\rm m} = \frac{a_{\rm s} - a_{\rm f}}{a_{\rm f}}.$$
$$\epsilon_{\rm m} = \frac{f}{M_{\rm f} h_{\rm f}}$$

### Формула Стони (Stoney formula)

Граничные условия на поверхности σ<sub>kz</sub>=0 и условия равенства нулю равнодействующей силы и момента.

Net force and torque must be zero for equilibrium.

Для изотропной среды:  $\epsilon_{\theta\theta} = \epsilon_{rr} = \epsilon_o - \kappa z$ В случае тонкой пленки на толстой подложке

1 10

$$\int_{-h_s/2}^{h_s/2} M_s(\varepsilon_0 - \kappa z) dz = -f; \Rightarrow M_s \varepsilon_0 z \Big|_{-h_s/2}^{h_s/2} = -M_f \varepsilon_m h_f; \Rightarrow \varepsilon_0 = -\frac{M_f h_f}{M_s h_s} \varepsilon_m$$

$$\int_{-h_s/2}^{h_s/2} ZM_s(\varepsilon_0 - \kappa z) dz = -fh_s/2; \Rightarrow M_s \kappa \frac{z^3}{3} \Big|_{-h_s/2}^{h_s/2} = M_f \varepsilon_m h_f h_s/2; \Rightarrow \kappa = \frac{6M_f h_f}{M_s h_s^2} \varepsilon_m$$

$$\int_{-h_s/2}^{0} Copatheli paduyc кривизны структуры - curvature (Stoney formula)$$

$$\epsilon_0 = -\frac{f}{M_s h_s} \quad \epsilon_{rr} = \frac{\sigma_{rr}}{E_s} - \nu_s \frac{\sigma_{rr}}{E_s} = \frac{\sigma_{rr}}{M_s}$$

 $\epsilon_{rz} = \epsilon_{\theta z} = 0; \sigma_{zz} = 0 \ \epsilon_{r\theta} = 0 \qquad M_{\rm s} = E_{\rm s}/(1-\nu_{\rm s})$ 

# Multi-beam optical stress sensor



### Упругие деформации в пленке и подложке



The distribution of normalized strain  $\varepsilon_{rr} = \varepsilon_m$  versus normalized distance  $z/h_s$  across the thickness of a substrate-film system for three values of the ratio  $h_f/h_s$ . The neutral plane of the substrate is located by the value of z at which  $\varepsilon_{rr}/\varepsilon_m = 0$ . The material properties are such that  $M_f/M_s = 1$ .

### Точность формулы Стони Accuracy of Stoney formula

$$\sigma_{rr} = \begin{cases} M_s(\varepsilon_0 - \kappa z) & \text{for } -\frac{1}{2}h_s < z < \frac{1}{2}h_s \\ M_f(\varepsilon_0 - \kappa z + \varepsilon_m) & \text{for } \frac{1}{2}h_s < z < \frac{1}{2}h_s + h_f \end{cases}$$

$$\frac{\kappa}{\kappa_{\rm St}} = \left(1 + \frac{h_{\rm f}}{h_{\rm s}}\right) \left[1 + 4\frac{h_{\rm f}}{h_{\rm s}}\frac{M_{\rm f}}{M_{\rm s}} + 6\frac{h_{\rm f}^2}{h_{\rm s}^2}\frac{M_{\rm f}}{M_{\rm s}} + 4\frac{h_{\rm f}^3}{h_{\rm s}^3}\frac{M_{\rm f}}{M_{\rm s}} + \frac{h_{\rm f}^4}{h_{\rm s}^4}\frac{M_{\rm f}^2}{M_{\rm s}^2}\right]^{-1},$$

$$\kappa \approx \frac{6\epsilon_{\rm m}}{h_{\rm s}} \frac{M_{\rm f}}{M_{\rm s}} \frac{h_{\rm f}}{h_{\rm s}} \left[ 1 + \left( \frac{M_{\rm s} - 4M_{\rm f}}{M_{\rm s}} \right) \frac{h_{\rm f}}{h_{\rm s}} \right]$$

Экспериментальное определение кривизны структур Experimental study of curvature

- Лазерное сканирование поверхности (Laser scanning)
- Многолучевое оптическое отражение (Multibeam optical reflection)
- Отражение изображения светлой сетки (Grid reflection)
- Изменение картины интерференции (Optical interference fringes)

# Scanning laser method



Используется для in-situ мониторинга деформаций при наращивании пленок, например, при MBE и MOCVD.

### Grid reflection method



### Coherent gradient sensor method



По изменению интерференции измеряются изменения кривизны

Многослойные структуры Multilayer structures

$$\kappa = \frac{6}{M_{\rm s}h_{\rm s}^2} \sum_{i=1}^{N_{\rm f}} \Delta f_i = \sum_{i=1}^{N_{\rm f}} \Delta \kappa_{\rm St,i}$$

To 1-rst order in the small parameters  $h_i/h_s$ , the total curvature is equal to the simple sum of the curvatures that would be induced if each individual layer would be deposited by itself on the substrate. Each individual curvature  $\kappa_{St;i}$  is given by the Stoney formula.

### Влияние анизотропии на деформации Anisotropy in curvature



Область геометрически-нелинейных деформаций Geometrically nonlinear deformations



Вращения, вызванные изгибом с вертикальным смещением w(r), могут быть не малы, даже если деформации малы. Stoney formula:  $w'(R) = \kappa R$  and  $\varepsilon_0 = 1/6 \kappa \cdot h_s$  $\frac{\{w'(R)\}^2}{2\epsilon} = 3\kappa R \frac{R}{h} \sim 1$ 

В выражение для деформации надо добавить член второго порядка малости, связанный с вращениями. Членами второго порядка малости, связанными с растяжением-сжатием, пренебрегаем.  $\epsilon_{rr}(r,z) = u'(r) - zw''(r) + \frac{1}{2} \{w'(r)\}^2$ 

### Изменение кривизны по площади Variation of curvature



Experimentally observed and numerically estimated variation of curvature as a function of radial position, measured from the center of a Si substrate with a W film deposit. After Finot et al. (1997).

### Bifurcation in equilibrium shape



# Экспериментальное определение упругих деформаций в пленках

- Experimental determination of strain in films
- Измерения параметра решетки пленок по рентгеновской дифракции
   X-ray diffraction
- Измерения кривизны структур Optical measurements of curvature
- Микро-Рамановская спектроскопия Micro-Raman scattering
- Просвечивающая электронная микроскопия Transmission electron microscopy
- Изменение энергий электронных состояний Change in electronic states

### Микро-Рамановская спектроскопия Micro-Raman scattering



### Просвечивающая электронная микроскопия Transmission electron microscopy



Численный анализ электронномкроскопических изображений позволяет построить поле смещений.

Strain mapping into a uniaxial 45 nm strained channel pinched between Si<sub>80</sub>Ge<sub>20</sub> source and drain. Simulation is on the left and experiment on the right. Courtesy of *CEMES-CNRS*, *Toulouse*, *France* 

### Изменение энергий электронных состояний Change in energy of electronic states



# Домашнее задание (Homework) 3

Пленка Ge толщиной 4 нм выращена эпитаксиально на подложке Si толщиной 400 мкм с ориентацией (111).

*Epitaxial 4nm Ge film was grown on 400µm Si (111) substrate.* Определить (*determine*):

1) Тензоры напряжений и деформаций в пленке в предположении, что подложка не деформируется.  $\underline{\sigma}$  and  $\underline{\varepsilon}$ , for rigid substrate

2) Радиус кривизны структуры по формуле Стони. *Stoney curvature*.

3) Тензоры напряжений и деформаций в пленке и в подложке с учетом кривизны. *Stress and strain tensors in the structure with curvature*.

Material	$egin{array}{c} a_0\ ({ m \AA}) \end{array}$	$ ho \ ({ m g/cm}^3)$	$c_{11}$ (GPa)	$c_{12}$ (GPa)	$c_{44}$ (GPa)
Silicon (Si) Germanium (Ge) Diamond (C)	5.4307 5.658 3.567	$2.330 \\ 5.323 \\ 3.515$	$165 \\ 129 \\ 1040$	$64 \\ 48 \\ 170$	$79.2 \\ 67.1 \\ 550$